



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	钝化半导体接触表面的功率半导体器件结构及制备方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201210449247.2
申请日期:	2012-11-09
专利号:	201210449247.2
第一发明人:	徐承福;朱阳军;胡爱斌;谈景飞;卢烁今;陈宏;吴凯
实施情况:	授权

